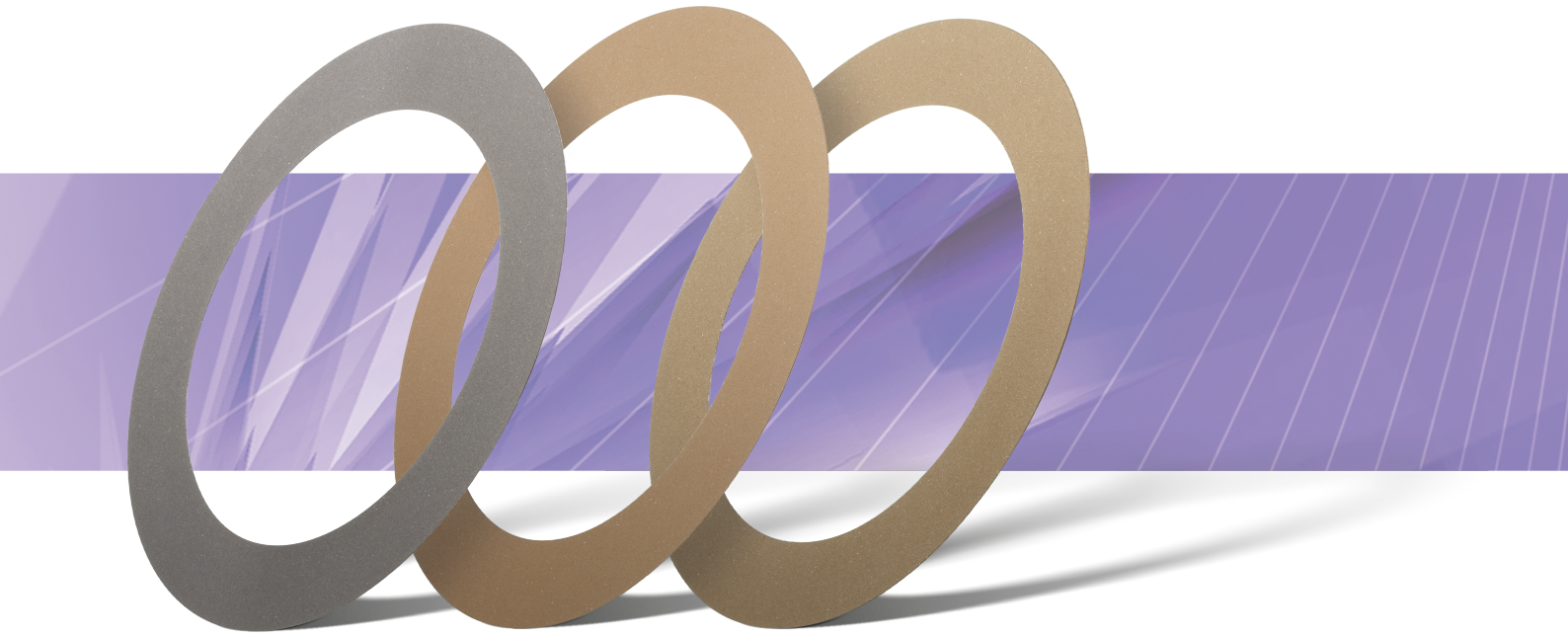
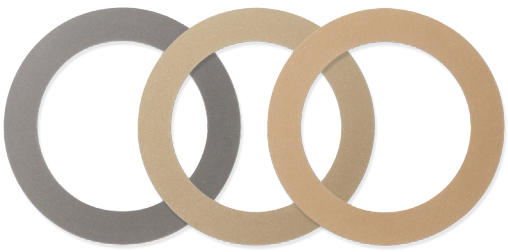
PRECISION ACCRETECH BLADE

METAL BOND BLADES
メタルブレードHMシリーズ

ACCRETECH
TOKYO SEIMITSU

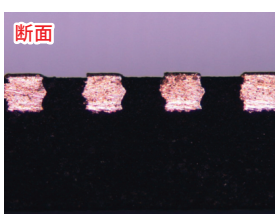


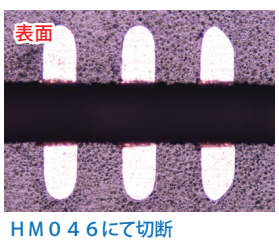
BGAやQFNなどの各種電子部品切断に
豊富なボンドバリエーションでお応えするHMシリーズ



- 高い焼結技術で、あらゆるアプリケーションに対応できる特性を引き出す
- 独自製法により均一な砥粒分散と性能安定性を実現
- 特殊砥粒を使用し、高い切れ味と耐磨耗性向上を実現
- QFNパッケージ切断用にも実績

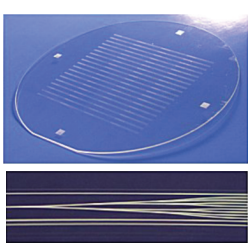
■加工例　メタルブレード（HMシリーズ）



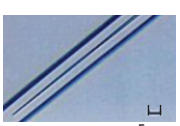


HM０４６にて切断

■ QFNパッケージ切断
一般的にレジンブレードが使用されるこの世界で、メタルブレードによる切断に成功。寿命改善にお試しください。

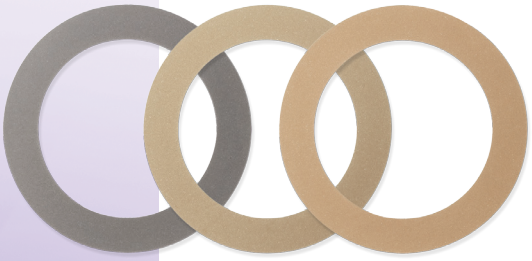


■ PLC（石英ガラス）切断
この切断分野において高シェアを有する。切断品位、性能安定性で高評価をいただいております。



PRECISION ACCRETECH BLADE

METAL BOND BLADES
メタルブレードHMシリーズ



■仕様と表示方法

MD	400	-	75	HM030
砥粒	砥粒径		集中度	結合材

■砥粒

MD	標準砥粒
XD	コーティング砥粒

■集中度

25, 50, 75, 100

■寸法と表示方法

58D	0.3T	40H	2d	0.5W	16N
外径	刃厚	内径	スリット深さ	スリット幅	スリット本数

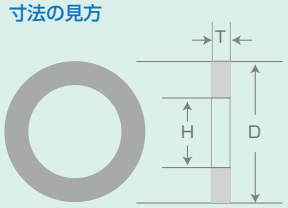
■寸法規格

外径D(mm) 公差+0.1/-0	刃厚T(mm) 公差±0.005 *1	内径H(mm) 公差H6	スリット深さd (mm)	スリット幅W (mm)	スリット数
50≦D≦100	0.05≦T≦0.4	40	※突出し量による	0.5	8,16,32

*1 #270,325は±0.01
#200,230は±0.015

スリット加工は刃厚0.1T以上から対応いたします。

寸法の見方



■粒度による製造可能タイプ

粒度	砥粒	
	MD	XD
4000	●	
2500	●	
2000	●	●
1300	●	●
1200	●	●
1000	●	●
800	●	●
700	●	●
600	●	●
500	●	●
400	●	●
325	●	●
270	●	●
230	●	●
200	●	●

■粒度による製造可能刃厚

粒度	刃厚(mm)				
	0.05≦T <0.08 *2	0.08≦T <0.1	0.1≦T <0.15	0.15≦T <0.25	0.25≦T <0.4
4000	●	●	●	●	●
2500	●	●	●	●	●
2000	●	●	●	●	●
1300	●	●	●	●	●
1200	●	●	●	●	●
1000	●	●	●	●	●
800			●	●	●
700			●	●	●
600			●	●	●
500			●	●	●
400					●
325					●
270					●
230					●
200					●

*2 外径56D以下で対応いたします。

■結合材

HM013	軟らかい
HM020	
HM024	標準
HM030	
HM050	
HM051	硬い
HM046	

■ご注文に際して

ご注文にあたっては、当社カタログを参考に下記の項目について出来るだけ詳しくお知らせ下さい。

1) 形状、寸法／具体的ブレード形状とご要求精度等
2) 仕様／ご希望の弊社仕様、現在ご使用中の製品の使用等
3) 切断ワーク・切断条件／使用機器、回転数、送り速度、クーラント流量等

■ご使用に際して

安全に使用していただくために、またブレードの性能を十分に引き出すために、ご使用の前に製品に添付されている取り扱い説明書及び検査票の記載事項、加工機取り扱い説明書を良くお読みの上ご使用下さい。

※本カタログは予告なく変更することがあります。
※本カタログは製品性能を保証するものではありません。

株式会社東京精密
〒192-0032　東京都八王子市石川町2968-2　TEL. 042-631-5211　FAX. 042-631-5234　https://www.accretech.com

C-93-585-J-2405